UV剥離テープSELFA™シリーズ

SELFA™シリーズは高い接着性と剥離しやすさを両立させたUV剥離テープです。

耐熱性と剥離技術により新しい半導体プロセスを実現

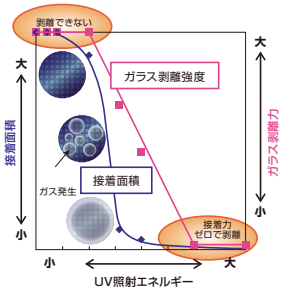
製品HP／お問合せ

特　徴

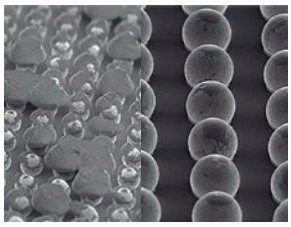
■軽剥離

超薄デバイスへの適用

ガス発生によりダメージレスで剥離



■耐熱性 / 低残渣



	一般UVテープ	SELFA™
耐熱性	×（150度以下）	220℃ @ 2hr + Reflow
残渣	×	○ 残渣レス

リフローなど各種熱工程
幅広いプロセスウィンドウ
熱工程後でも残渣レスを実現

■ラインナップ

品名	タイプ	高耐熱	剥離方法	基材種類	デバイス側 粘着種類	支持材側 粘着種類	UV波長 (nm)	UV照射量 (mJ/cm²)
HW	両面	○	ピール	耐熱フィルム	UV硬化粘着剤	ガス発生	405	3000
			ガス剥離				254	12000
HS	片面	○	ピール	耐熱フィルム	UV硬化粘着剤	-	405	3000
MP	片面		ガス剥離	PET	ガス発生	-	365	3000

テープ

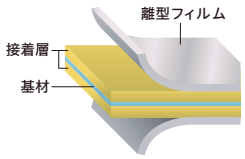
両面 耐熱高接着易剥離UVテープ(～260℃)

SELFA™ HW

接着・粘着　保護　熱マネージメント

製品HP／お問合せ

特徴・用途例

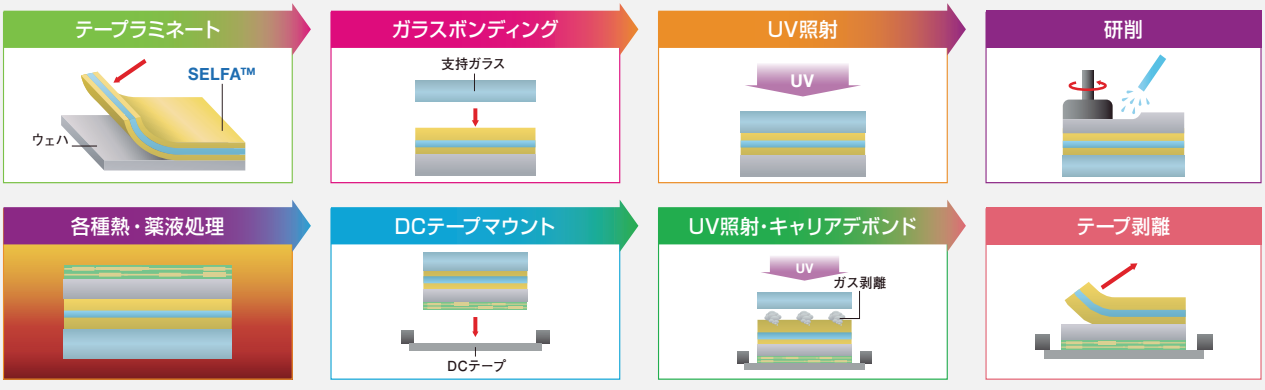


1. 両面 耐熱高接着易剥離UVテープ(～260℃)
2. テープ式ガラスサポートによりハンドリング性向上
3. ガス発生によるキャリアデボンド
4. 優れた耐熱性、耐薬品性

用途例

ガラスキャリアサポート

使用例



テープ

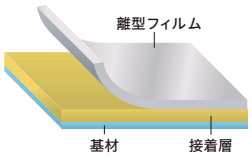
片面 耐熱高接着易剥離UVテープ（～250℃）

SELFA™ HS

接着・粘着　保護　熱マネージメント

製品HP／お問合せ

特徴・用途例



1 片面 耐熱高接着易剥離 UVテープ（～250℃）

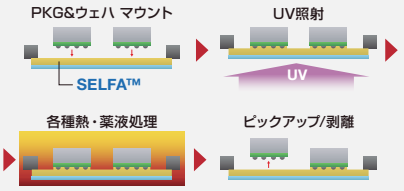
2 優れた耐熱性、耐薬品性を両立

3 プロセス耐性＋低残渣の両立

用途例

熱工程時のデバイス保護・反り矯正（リフローなど）

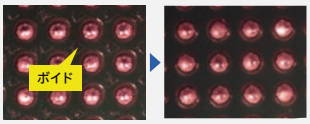
使用例



性　能



リフロー時のデラミ、テープ剥離後の残渣無し



（バンプ高さ：150um　バンプ径：250um）
糊厚調整でバンプ付きウェハにも適用可能

テープ

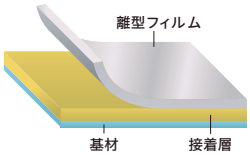
片面 自己剥離UVテープ（～90℃、ガス発生タイプ）

SELFA™ MP

接着・粘着　保護　熱マネージメント

製品HP／お問合せ

特徴・用途例



1 片面 自己剥離UVテープ（～90℃、ガス発生タイプ）

2 強接着による高い薬液耐性

3 ガス発生によるダメージレス剥離

用途例

薬液保護（UBM めっきプロセス、強酸、強アルカリ）

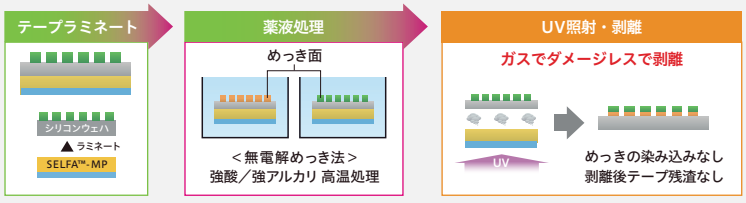
一般物性

項目		単位
テープ厚み	基材	25μm
	粘着剤	30μm

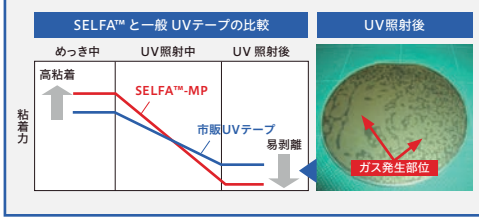
項目		単位	SUS	シリコンウェハ	金めっき
粘着力	初期	N/25mm	15.5	14.1	10.5
	UV照射後		≒0	≒0	≒0

※接着力：180° ピール 300mm/min、UV 照射：3000mJ/cm²

使用例



性　能



テープ

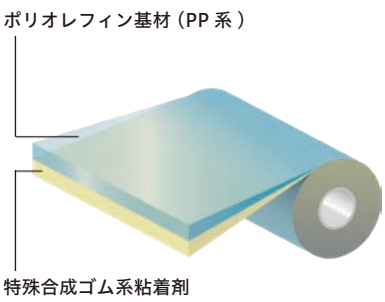
光学フィルム用プロテクトテープ

6700/6800シリーズ

接着・粘着　保護

特　徴

強粘着タイプ

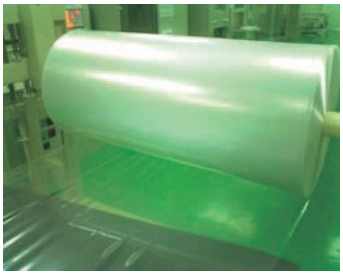


1 強粘着：凹凸面にもしっかり貼りつき、保護

2 糊残り無し：被着体を汚染せず、きれいにはがせる

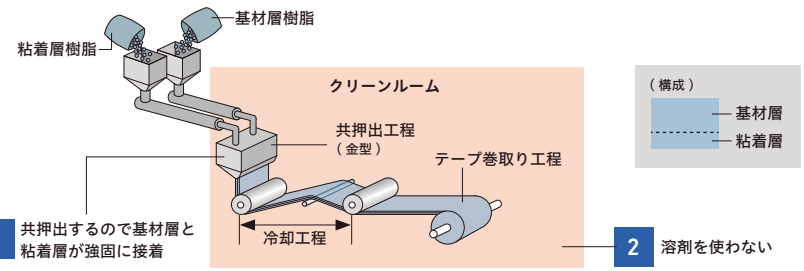
3 共押出工法：無溶剤製法で環境にやさしい生産方法

4 クリーン環境：異物が入りにくいシンプル工法


強粘着タイプ（PP 系フィルム）

■当社プロセス

特徴 1 基材層と粘着層が強固に接着されているので被着体への糊残りがほとんどありません。
2 無溶剤製法なので、環境にやさしい生産方法です。



一般物性

■ 6700 シリーズ

品名			6748C	6754A
色			透明	透明
標準厚み	μm		40	30
Haze	%		40	50
粘着力 (23℃ ,PMMA板)	180°ピール	N/25mm	6	5
	90°ピール		2.5	2
用途			輝度上昇フィルム	
			プリズム面	

■ 6800 シリーズ

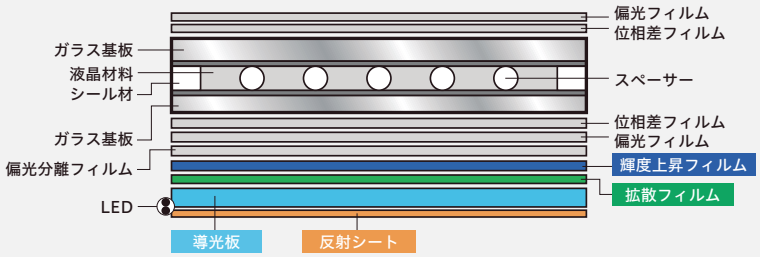
品名			6842A	6846A
色			透明	透明
標準厚み	μm		40	30
Haze	%		40	40
粘着力 (23℃ ,PMMA板)	90°ピール	N/25mm	0.4	0.1
用途			輝度上昇フィルム	
			マット面	

※記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。

用途例

●光学フィルムの表面保護
（拡散フィルム、輝度上昇フィルム、導光板、反射シート等）

■液晶ディスプレイ断面図



テープ

機能フォームテープ

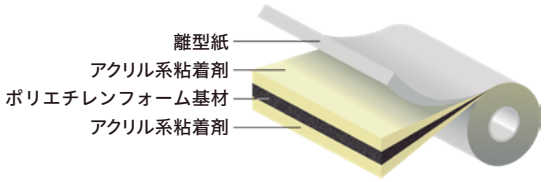
5200シリーズ

接着・粘着　防水・防塵　防振・衝撃吸収

製品HP／お問合せ

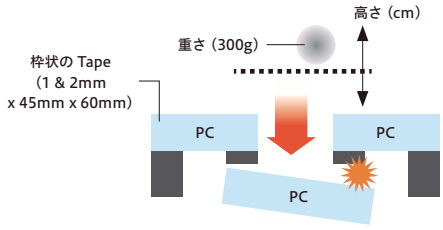
特　徴

■ #5200WPシリーズ　　応力緩和性に優れたフォームと粘着材との組み合わせで、高い衝撃吸収を可能にしたテープです。



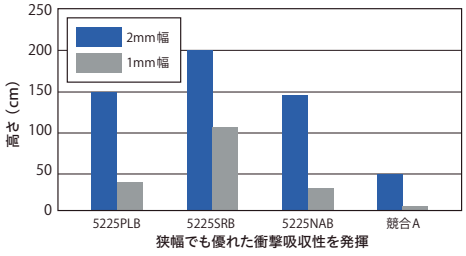
1. 高い衝撃吸収性で落下による剥がれや破損を抑制
2. 段差追従性に優れ、高い防水、防塵性能を発揮
3. 耐反発性に優れ、曲面貼り付け時の高い接着信頼性

高い落下衝撃性



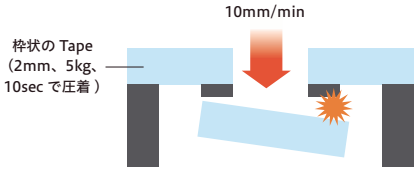
重りを落下させ、
PC 板が剥がれた
高さを計測

■衝撃試験【耐落下衝撃性評価】



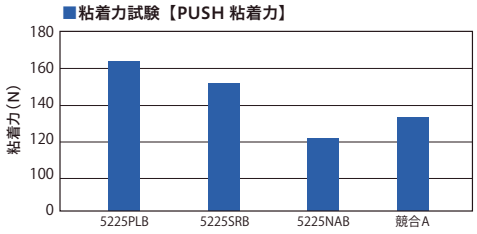
狭幅でも優れた衝撃吸収性を発揮

高粘着性

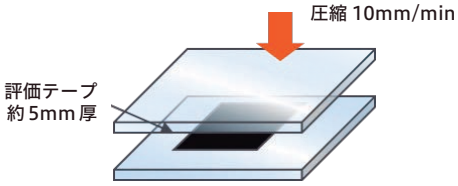


PC 板に空いた
穴から荷重をかけ、
被着体板から
外れた荷重を比較

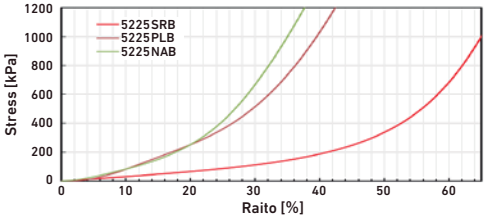
■粘着力試験【PUSH 粘着力】



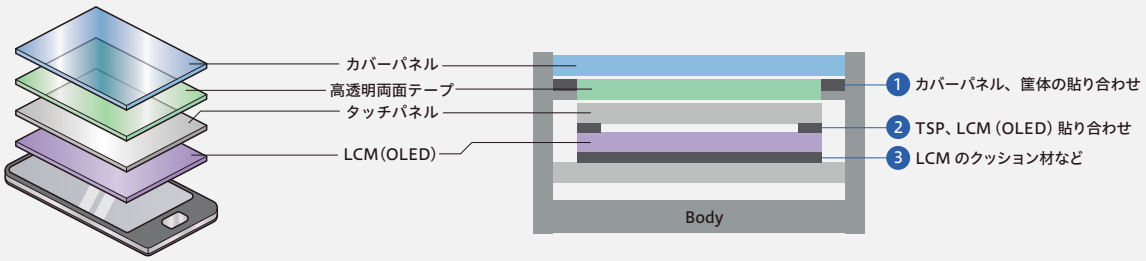
高柔軟性



5mm 厚に積層した
テープに荷重を加え、
圧縮強度を測定



用途例



テープ

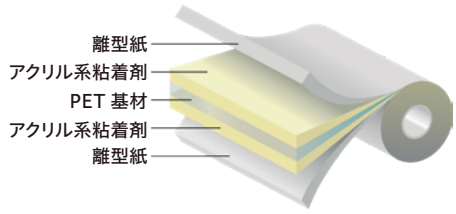
LCD部材固定用両面テープ

3800シリーズ

接着・粘着　反射・遮光

製品HP／お問合せ

テープ構成＆特徴



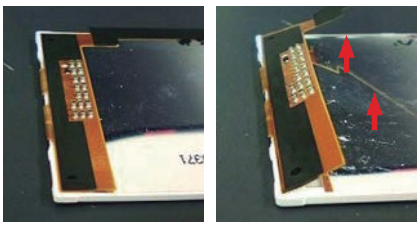
1 高い接着性を有し、耐反発性と応力緩和性のバランスの優れたテープ

2 優れた遮光性と反射特性

3 20μm～200μmまで幅広いラインナップ

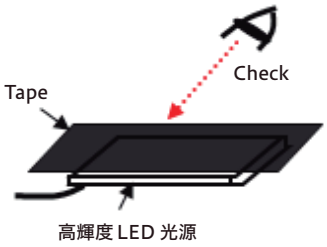
高接着性

高い接着性　浮上がる

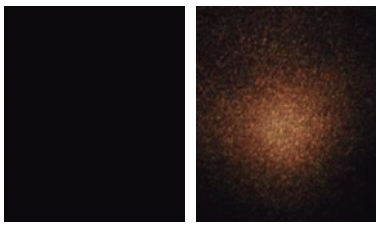


SEKISUI　COMPETITOR

遮光性



完全遮光　光漏れ



SEKISUI　COMPETITOR

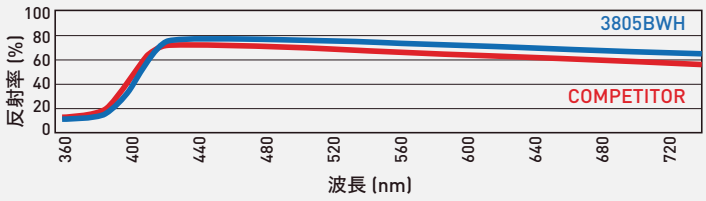
物　性

■一般物性

項目	単位	3805BWH	3805BH
白面粘着力(対PC板)	N/25mm	15.2	15.2
黒面粘着力(対ガラス板)		13.8	14.3

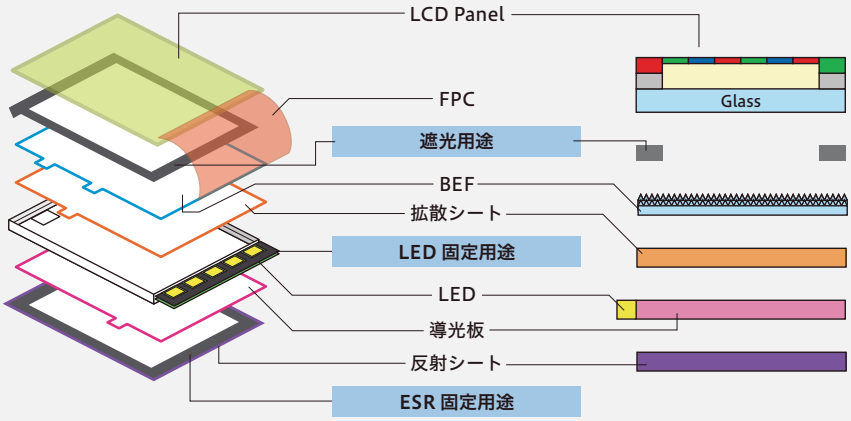
※記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。

■反射特性

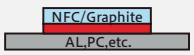


用途例

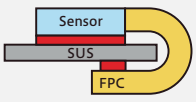
■表示パネル周辺



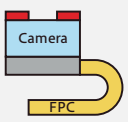
■小部品周辺



NFC/Graphite 固定用途



センサー /FPC 固定用途



カメラ遮光用途

テープ

液晶ガラス基板・CMP・HDD基板

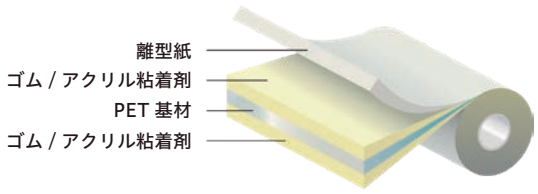
研磨布固定用両面テープ

接着・粘着

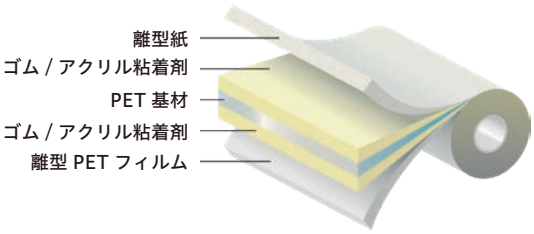
製品HP／お問合せ

特　徴

シングルセパレータタイプ



ダブルセパレータタイプ



液晶ガラス基板製造工程をはじめ、電子材料製造工程で幅広く使用されている両面テープ

1. フィルム基材を使用のため、再剥離が可能
2. 裏表で粘着剤が異なるディファレンシャル設計
3. 優れた粘着剤面の平滑性（ダブルセパレータタイプ）
4. 研磨中のテープと被着体の剥がれなし
5. 厚み23μm～250μm/最大2450mm幅対応可能

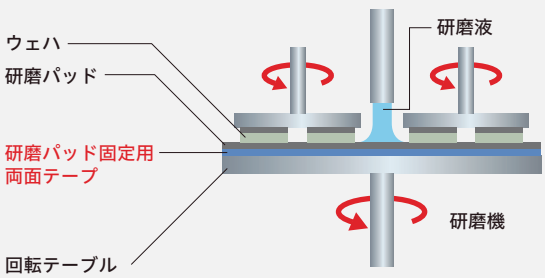
一般物性

項目		感圧型		感熱型
		一般タイプ	ディファレンシャルタイプ	ディファレンシャルタイプ
テープ厚み（μm）		130	108	138
粘着力（N/25mm）（SUS、23℃）	強粘着面	6	12	30
	弱粘着面	5	6	20
粘着剤		アクリル系	アクリル系	アクリル系
基材		OPP	PET	PET
ライナー		シングルセパ 紙	ダブルセパ 紙/フィルム	シングルセパ ダブルセパ 紙/フィルム
用途例		シリコンウェハ研磨	CMP ハードディスク基板研磨	CMP 液晶ガラス基板研磨

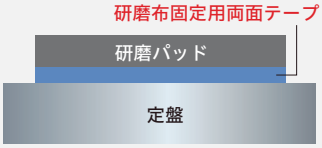
※粘着力の測定方法は JIS Z 0237 に準拠
※記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。

用途例

- 液晶ガラス基板のポリッシングパッド、パッキングフィルム固定
- シリコンウェハ、ハードディスク基板等のポリッシングパッド固定
- CMP パッド固定
- ラビングクロス固定など



■研磨布固定用両面テープの役割



精密研磨工程で研磨布を定盤に固定し、工程完了後に容易に糊残りなく剥離することが可能です。